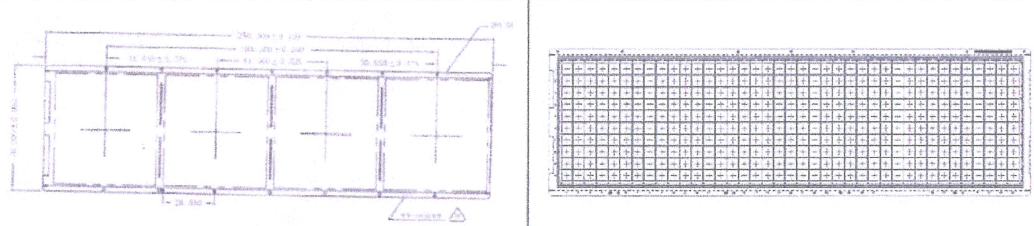
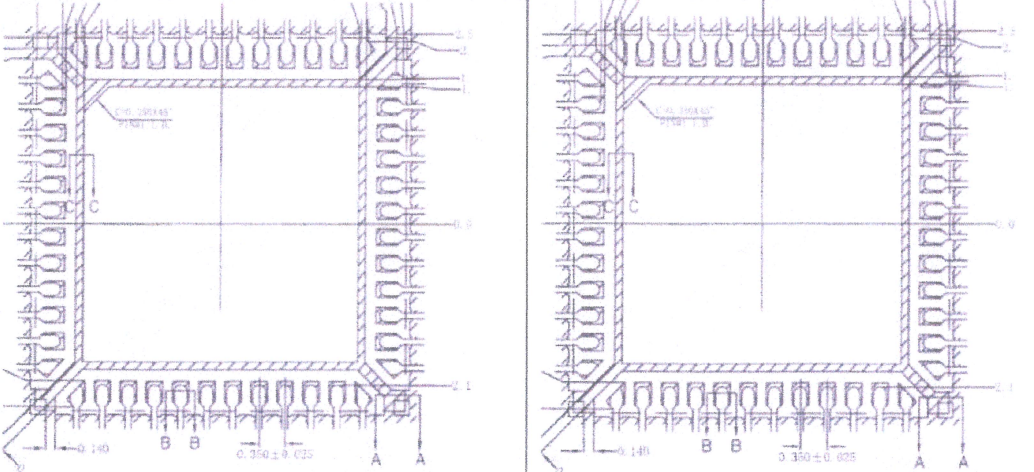
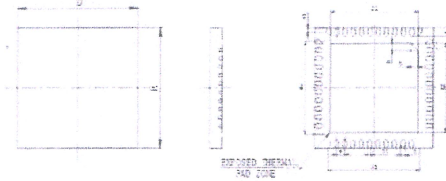
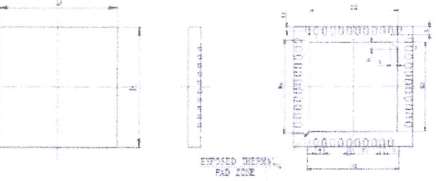
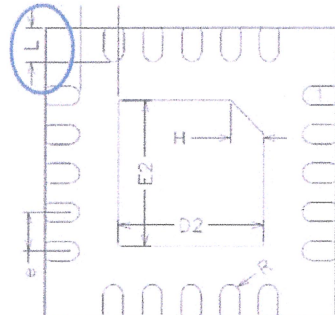



QFN48 5x5 扩产的通知

客户名称	ALL	联系人	NA
------	-----	-----	----

受影响产品	商业名称	物料编码
	HC32F460JEUA-QFN48TR	2F460JE0-0104B0QA0R
	HC32F460JEUA-QFN48TR	2F460JE0-0104B2QA1R

变更原因	为缓解封装产能压力，保证客户产品正常出货，对以上料号的封装产能进行扩充。			
变更方法描述	原西安华天 QFN(0505-0.35)048(B)-154×154(C)-4B-0.152T 框架，由 4B 升级为 1B，提高封装效率：			
	目前使用(4B)	升级替换为(1B)	备注	
	QFN(0505-0.35)048(B)-154×154(C)-4B-0.152T 华洋/ASM	QFN(0505-0.35)048(B)-0002 QPL	1B 框架量产使用中	
	两款框架异同点：			
	BLOCK	4B	1B	不同
	框架尺寸	250×70	258×78	不同
每条数量	440	552	不同	
厚度	0.152	0.152	相同	
框架外形			不同	
单颗设计			不同	

	<p>POD</p> 		<p>相同</p>								
<p>框架材质无变化，molding compound 无变化。</p>											
<p>2</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 封测供应商由目前的一家（西安华天科技股份有限公司），扩充到三家（新增通富微电子股份有限公司和星科金朋半导体有限公司）； 2. 三家封装供应商均为国内排名前三，同为华大合格供应商，且有多款产品量产； 3. 封装芯片外形尺寸及外观无明显变化（除了端子长度L稍有不同，不影响客户使用）； 4. 芯片表面印章排版及内容无明显变化； 5. 芯片的功能及性能无影响。  <table border="1" data-bbox="638 985 1133 1064"> <thead> <tr> <th>尺寸</th> <th>西安华天</th> <th>通富微电</th> <th>星科金朋</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L</td> <td>0.35±0.05</td> <td>0.35±0.05</td> <td>0.4±0.1</td> </tr> </tbody> </table>			尺寸	西安华天	通富微电	星科金朋	L	0.35±0.05	0.35±0.05	0.4±0.1
尺寸	西安华天	通富微电	星科金朋								
L	0.35±0.05	0.35±0.05	0.4±0.1								
<p>变更生效日期或产品 Date Code 说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 方案一框架升级 2021/1/20 开始生效； 2. 方案二扩后备供应商 2021/2/26 开始生效。 											

<p>发行人</p>	<p>康超</p>	<p>发行日期</p>	<p>2020/12/04</p>
<p>华大半导体 MCU 事业部工程部经理签署：</p> <p style="text-align: center;">孙广军</p>		<p>日期：</p>	

<p>客户</p>	<p>部确认意见：</p>
<p>签署：</p>	<p>日期：</p>

✦ 以上，特此通知，如果您有任何意见或建议，请随时与我司销售部门联系。 ✦